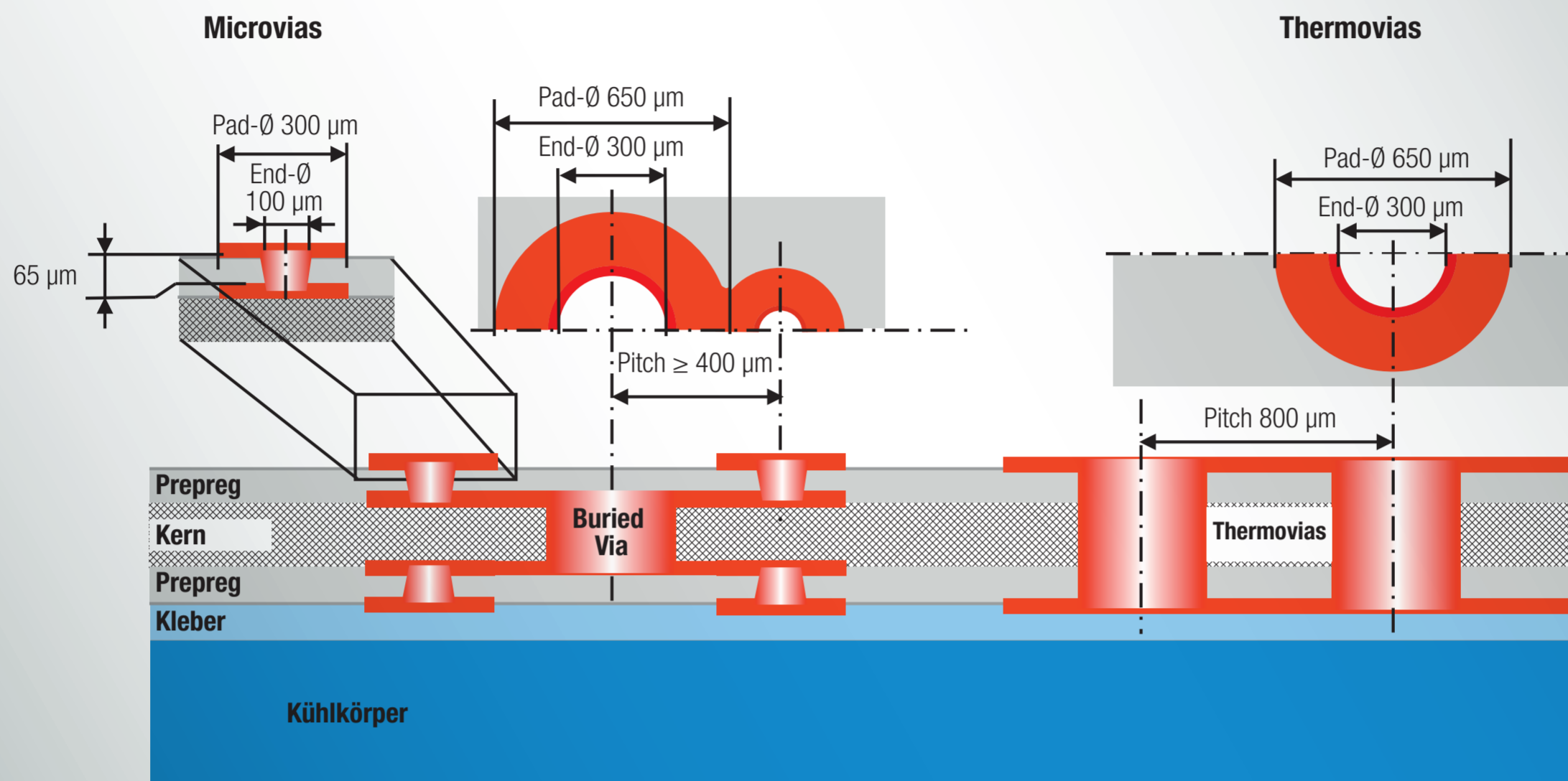


# Wärmemanagement Design Guide



## Standard Design Regeln



### Kombination Microvia, Buried Via als Thermovias

### Thermovias gefüllt (Filled & Capped Via Typ 7)

### Sollbruchstellen Heatsink

**Positive Sollbruchstellen**  
Bruchstelle befindet sich im Fräskanal außerhalb der Leiterplattenkontur.

**Negative Sollbruchstellen**  
Bruchstelle innerhalb der Leiterplattenkontur. Zusätzliche Zwischenstege zur Stabilität des Nutzens benötigt.

### Thermische Simulation

Leiterplatte 2 Lagen, 1,6 mm, verbessertes Layout, ohne Thermovias

Leiterplatte 2 Lagen, mit Heatsink, 1,6 mm, verbessertes Layout, mit Thermovias

Eine thermische Simulation der Leiterplatte kann helfen, den besten Leiterplattenaufbau und das optimale Layout auszuwählen.